



平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年8月3日

上場取引所 東大

上場会社名 住友ベークライト株式会社
コード番号 4203 URL <http://www.sumibe.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 林 茂
問合せ先責任者 (役職名) 経理企画本部副本部長 (氏名) 寺島 郁朗

TEL 03-5462-3452

四半期報告書提出予定日 平成24年8月13日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (証券アナリスト、機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成25年3月期第1四半期の連結業績(平成24年4月1日～平成24年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年3月期第1四半期	45,435	△2.5	2,006	△21.1	2,214	△32.6	841	△56.9
24年3月期第1四半期	46,623	△2.2	2,543	△22.0	3,286	△15.7	1,954	△7.1

(注) 包括利益 25年3月期第1四半期 3,046百万円 (△12.8%) 24年3月期第1四半期 3,492百万円 (223.5%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
25年3月期第1四半期	3.49	—
24年3月期第1四半期	8.11	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
25年3月期第1四半期	205,277	120,864	58.3
24年3月期	201,315	119,023	58.6

(参考) 自己資本 25年3月期第1四半期 119,701百万円 24年3月期 117,997百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
24年3月期	—	7.50	—	5.00	12.50
25年3月期	—	—	—	—	—
25年3月期(予想)	—	7.50	—	7.50	15.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	96,000	0.7	5,000	17.2	5,300	2.1	3,300	△8.7	13.70
通期	200,000	8.0	12,000	153.9	12,500	110.7	8,000	216.8	33.21

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 有
- ④ 修正再表示 : 無

(注)詳細は、添付資料4ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

25年3月期1Q	262,952,394 株	24年3月期	262,952,394 株
25年3月期1Q	22,035,068 株	24年3月期	22,034,107 株
25年3月期1Q	240,917,931 株	24年3月期1Q	240,927,435 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
(四半期連結損益計算書)	
(第1四半期連結累計期間)	7
(四半期連結包括利益計算書)	
(第1四半期連結累計期間)	8
(3) 継続企業の前提に関する注記	9
(4) セグメント情報等	9
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	10
(6) 重要な後発事象	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結累計期間の世界経済は、欧州は財政金融問題により低迷が続き、米国では回復にかけが見られ、中国などの新興国でも拡大のテンポが緩やかになるなど、全体として減速感が広がりました。

日本経済は、復興需要等を背景として緩やかに回復しつつありますが、世界経済の低迷や歴史的な円高の影響を受け、先行き不透明な状況が続きました。

当社グループを取り巻く経営環境は、半導体においては、スマートフォンやタブレット型多機能携帯端末向けは堅調に推移しましたが、薄型テレビやパソコン向けなどの不振が続き、全体としては低調でした。自動車につきましては、国内の販売はエコカー購入支援策により増加基調にあり、欧州は低迷しているものの、米国や中国などの新興国においても伸長しました。国内の住宅着工件数は、政府の住宅取得支援策や復興需要もあり緩やかに持ち直しました。

当社グループはこのような経営環境の中、身の丈経営によりスリム化した企業体質を維持しながら、次の方針を掲げて新たなる成長に向け総合力を結集して取り組んでおります。

- ①国内既存事業の再生、ビジネスモデルの転換
- ②新規事業立ち上げ、創生
- ③海外事業の収益力強化、規模拡大

この結果、当第1四半期連結累計期間の経営成績につきましては、円高により海外子会社の円換算売上高が目減りし、また半導体関連材料の販売数量はようやく底を打ち回復してきたものの、前年同期の水準まで達しなかったため、連結売上高は前年同期比で2.5%減少し454億35百万円となりました。

利益につきましては、クオリティオブライフ関連製品や回路製品の業績が改善したことにより、直前四半期よりも回復しましたが、半導体関連材料の業績は前年同期比で減益となったこともあり、連結営業利益は前年同期比21.1%減の20億6百万円、連結経常利益は前年同期比32.6%減の22億14百万円、連結純利益は前年同期比で56.9%減の8億41百万円となりました。

セグメント別販売状況(対前年同期比較)

①半導体関連材料

半導体封止用エポキシ樹脂成形材料、半導体実装用キャリアテープは、スマートフォンやタブレット型多機能携帯端末向けは好調でしたが、薄型テレビやパソコン向けの低迷や円高の影響などにより売上高は減少しました。

半導体基板材料「LαZ®」は、スマートフォンやタブレット型多機能携帯端末での採用が進み、売上高は伸長しました。また、今後の需要拡大への対応とともにコスト競争力を強化すべく、宇都宮工場内に第二の生産拠点を設置することを決定し、準備を進めています。

②回路製品

エポキシ樹脂銅張積層板およびフェノール樹脂銅張積層板は、車載向けは堅調でしたが、薄型TV等のAV機器市場の低迷により売上高は減少しました。

なお、フレキシブル・プリント回路事業につきましては、平成24年9月末の事業撤退に向け計画通りに進んでいます。

③高機能プラスチック

フェノール樹脂成形材料、工業用フェノール樹脂および成形品は、日本、北米の自動車分野が堅調に推移しましたが、欧州におけるタイヤや摩擦材などの低迷や円高により海外の売上高が目減りしましたので、全体として売上高はわずかに減少しました。一方で、シェールガス開発への需要増に対応して、2013年を目途に米国の生産能力を増強させるべく準備を進めています。

なお、工業用フェノール樹脂の生産販売会社である中国江蘇省南通市の「南通住友電木有限公司」のフェノール樹脂成形材料工場は、6月より本格稼働を開始しました。

④クオリティオブライフ関連製品

医療機器製品は、止血剤注入キットの伸長と腹腔用低圧持続ドレナージシステム「クリオドレーンパック®」、腹腔鏡手術用腹部開創具「X-Gate®」などの新製品の寄与により売上高は増加しました。

ビニル樹脂シートおよび複合シートは、医薬品包装用途がジェネリックメーカー向けを中心に好調であったものの、工業用途が低調で、全体として売上高は減少しました。

ポリカーボネート樹脂板、塩化ビニル樹脂板、メラミン樹脂化粧板・不燃板のプレート・デコラ事業は、異常気象の影響による補修用途で波板・エクステリア関連製品が増加しましたが、工業・光学分野の落ち込みにより売上高は前年同期並みとなりました。また、新製品の不燃の薄物メラミン化粧シート「デコライノベア」は、生産準備プロジェクトチームを新設し、安定的な生産・供給体制を整え、B to Bビジネスの強化、拡販を進めています。

防水関連事業は、政府の住宅取得支援策や復興需要などにより新築住宅、リフォームが好調で、蓄熱槽工事、材料販売も順調に推移し、売上高は増加しました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(資産、負債および純資産の状況)

①資産の部

総資産は、前連結会計年度末に比べ39億62百万円増加し、2,052億77百万円となりました。

これは主に、株式相場の下落に伴う時価評価・減損等により投資有価証券が18億8百万円減少した一方で、有形固定資産が27億32百万円、受取手形及び売掛金が14億17百万円増加したことおよび在外子会社の換算レートが前連結会計年度末に比べ円安に進行したため資産の円換算額が増加したことによるものであります。

②負債の部

負債合計は、前連結会計年度末に比べ21億22百万円増加し、844億13百万円となりました。

これは主に、賞与引当金が13億67百万円減少した一方で、コマーシャル・ペーパーを20億円増額したことおよび支払手形及び買掛金が19億19百万円増加したことによるものであります。

③純資産の部

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ18億41百万円増加し、1,208億64百万円となりました。

これは主に、四半期純利益を8億41百万円計上し、為替換算調整勘定が28億71百万円増加した一方で、配当金の支払12億4百万円があったことおよびその他有価証券評価差額金が11億37百万円減少したことによるものであります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成24年5月11日に公表いたしました業績予想の見直しは現時点では行っておりません。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社および一部の国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる損益への影響は軽微であります。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	26,957	27,177
受取手形及び売掛金	42,309	43,726
商品及び製品	9,842	9,866
半製品	2,690	2,770
仕掛品	687	746
原材料及び貯蔵品	9,932	10,416
その他	7,796	7,829
貸倒引当金	△63	△68
流動資産合計	100,152	102,466
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	29,047	30,104
機械装置及び運搬具(純額)	23,772	26,217
その他(純額)	21,924	21,155
有形固定資産合計	74,745	77,477
無形固定資産		
のれん	4,787	4,807
その他	1,556	1,561
無形固定資産合計	6,343	6,368
投資その他の資産	20,073	18,965
固定資産合計	101,162	102,811
資産合計	201,315	205,277

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	27,353	29,272
短期借入金	4,833	4,695
コマーシャル・ペーパー	12,000	14,000
未払法人税等	971	766
賞与引当金	2,475	1,108
事業再建費用引当金	2,198	1,942
その他	11,637	12,275
流動負債合計	61,470	64,060
固定負債		
長期借入金	10,600	10,600
退職給付引当金	6,996	6,597
その他の引当金	353	185
負ののれん	208	161
その他	2,661	2,809
固定負債合計	20,820	20,353
負債合計	82,291	84,413
純資産の部		
株主資本		
資本金	37,143	37,143
資本剰余金	35,358	35,358
利益剰余金	78,051	77,688
自己株式	△11,930	△11,930
株主資本合計	138,622	138,259
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,171	1,034
為替換算調整勘定	△20,850	△17,979
在外子会社の退職給付債務調整額	△1,945	△1,612
その他の包括利益累計額合計	△20,624	△18,558
少数株主持分	1,025	1,162
純資産合計	119,023	120,864
負債純資産合計	201,315	205,277

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)
売上高	46,623	45,435
売上原価	33,195	32,351
売上総利益	13,427	13,084
販売費及び一般管理費	10,883	11,077
営業利益	2,543	2,006
営業外収益		
受取利息	35	27
受取配当金	311	199
負ののれん償却額	205	47
持分法による投資利益	32	—
為替差益	236	64
雑収入	122	81
営業外収益合計	943	420
営業外費用		
支払利息	79	82
持分法による投資損失	—	3
雑損失	121	127
営業外費用合計	200	213
経常利益	3,286	2,214
特別利益		
固定資産売却益	3	159
受取保険金	—	59
その他	—	47
特別利益合計	3	265
特別損失		
固定資産除売却損	76	89
投資有価証券評価損	0	140
事業再建関連費用	71	—
減損損失	122	593
解決金等	331	—
その他	1	49
特別損失合計	604	872
税金等調整前四半期純利益	2,685	1,607
法人税、住民税及び事業税	541	357
法人税等調整額	155	364
法人税等合計	696	721
少数株主損益調整前四半期純利益	1,988	885
少数株主利益	34	43
四半期純利益	1,954	841

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	1,988	885
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△163	△1,137
為替換算調整勘定	1,671	2,959
在外子会社の退職給付債務調整額	△9	333
持分法適用会社に対する持分相当額	5	5
その他の包括利益合計	1,503	2,161
四半期包括利益	3,492	3,046
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,440	2,908
少数株主に係る四半期包括利益	52	138

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報等

I 前第1四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント					その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期 連結損 益計算 書計上 額 (注) 3
	半導体 関連材料	回路製品	高機能 プラス チック	クオリテ ィオブラ イフ関連 製品	計				
売上高									
外部顧客への売上高	13,257	4,021	15,131	14,049	46,459	164	46,623	—	46,623
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	125	25	151	—	151	△151	—
計	13,257	4,021	15,256	14,074	46,610	164	46,774	△151	46,623
セグメント利益又は 損失 (△)	1,498	△254	1,429	685	3,359	△17	3,341	△798	2,543

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、試験研究の受託、土地の賃貸等を含んでおります。

2 「セグメント利益又は損失 (△)」の調整額△798百万円には、セグメント間取引消去3百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△801百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない基礎研究費用等であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第1四半期連結累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント					その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期 連結損 益計算 書計上 額 (注) 3
	半導体 関連材料	回路製品	高機能 プラス チック	クオリテ ィオブラ イフ関連 製品	計				
売上高									
外部顧客への売上高	12,026	3,643	14,942	14,686	45,299	136	45,435	—	45,435
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	67	38	105	—	105	△105	—
計	12,026	3,643	15,010	14,724	45,404	136	45,541	△105	45,435
セグメント利益又は 損失 (△)	993	82	1,161	951	3,188	△50	3,137	△1,130	2,006

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、試験研究の受託、土地の賃貸等を含んでおります。

2 「セグメント利益又は損失 (△)」の調整額△1,130百万円には、セグメント間取引消去1百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,132百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない基礎研究費用等であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

各報告セグメントの主要な製品および役務の内容は以下のとおりであります。

報告セグメント	主要な製品および役務の内容
半導体関連材料	半導体封止用エポキシ樹脂成形材料、感光性ウェハーコート用液状樹脂、半導体用液状樹脂、半導体実装用キャリアテープ、半導体チップ接着用テープ、半導体基板材料
回路製品	フレキシブル・プリント回路、フェノール樹脂銅張積層板、エポキシ樹脂銅張積層板
高機能プラスチック	フェノール樹脂成形材料、工業用フェノール樹脂、精密成形品、合成樹脂接着剤
クオリティオブライフ関連製品	医療機器製品、メラミン樹脂化粧板・不燃板、ビニル樹脂シートおよび複合シート、鮮度保持フィルム、ポリカーボネート樹脂板、塩化ビニル樹脂板、防水工事の設計ならびに施工請負、バイオ製品

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

(6) 重要な後発事象

該当事項はありません。